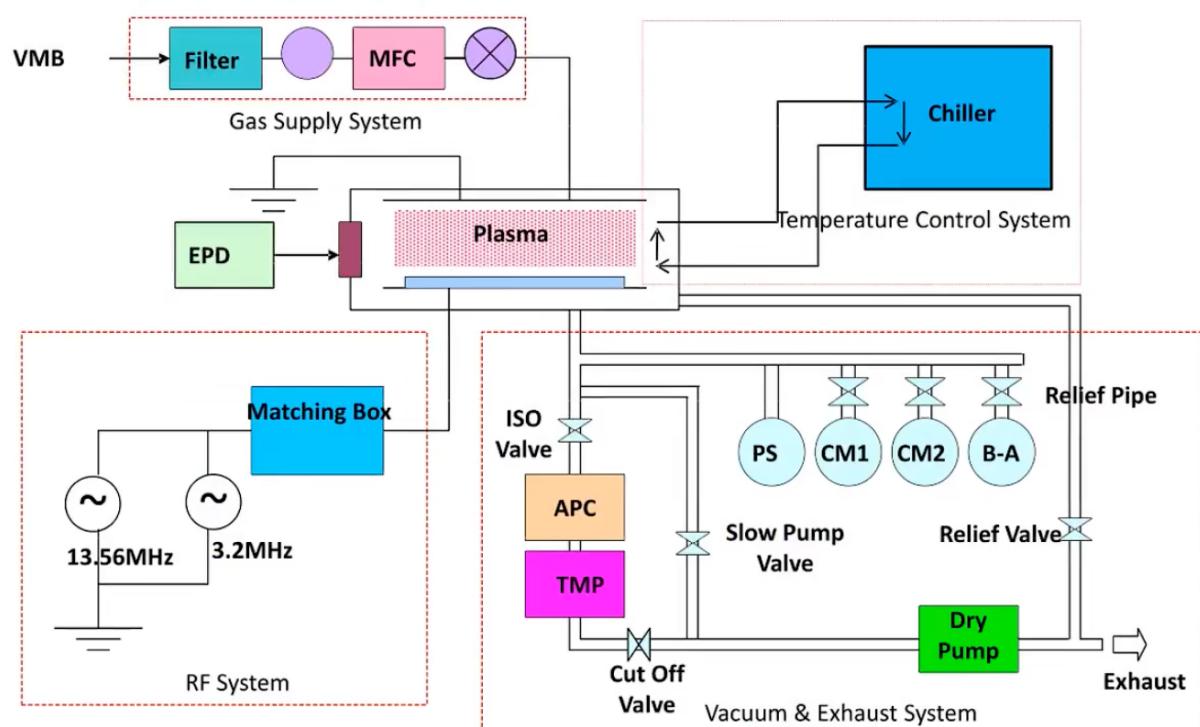
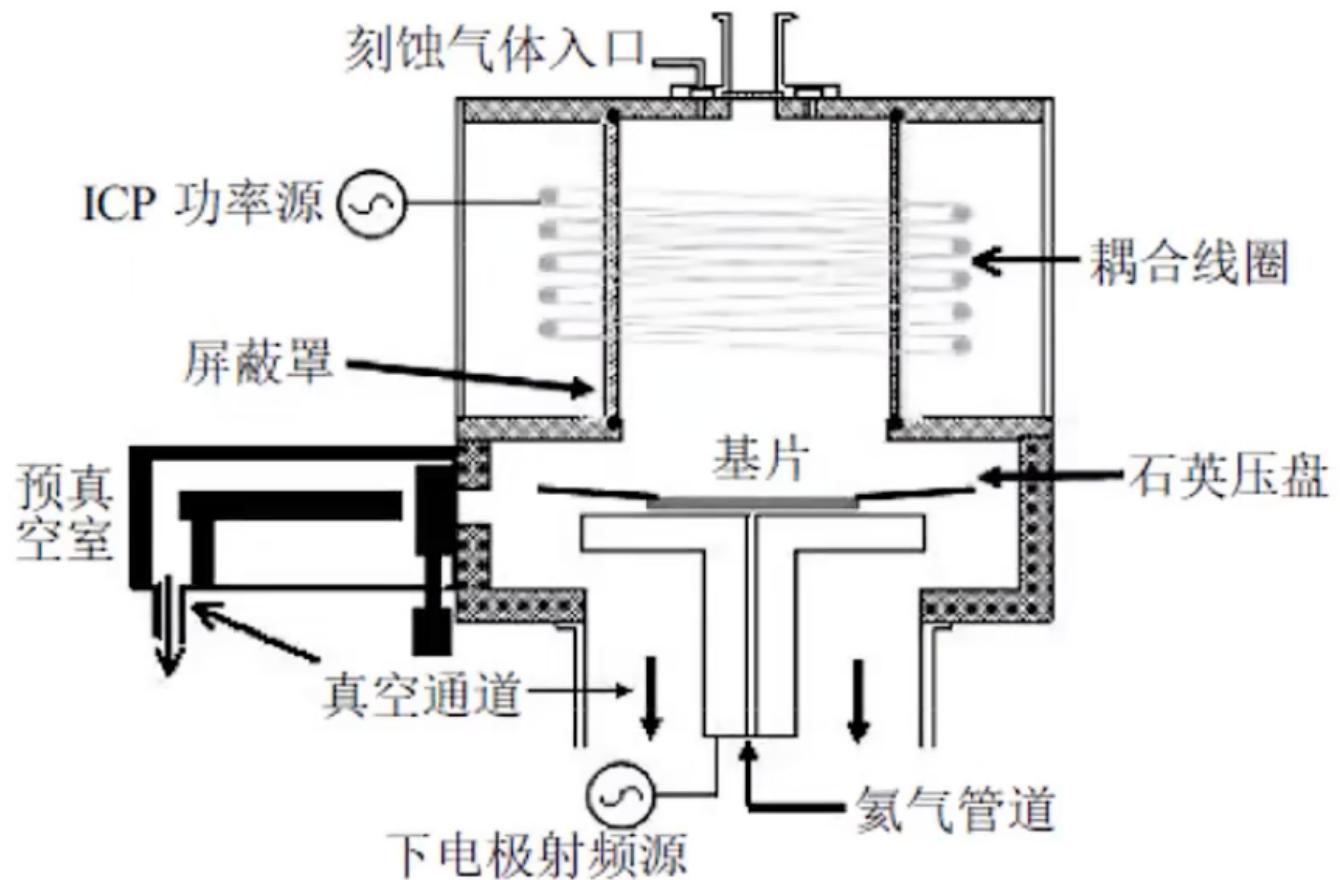


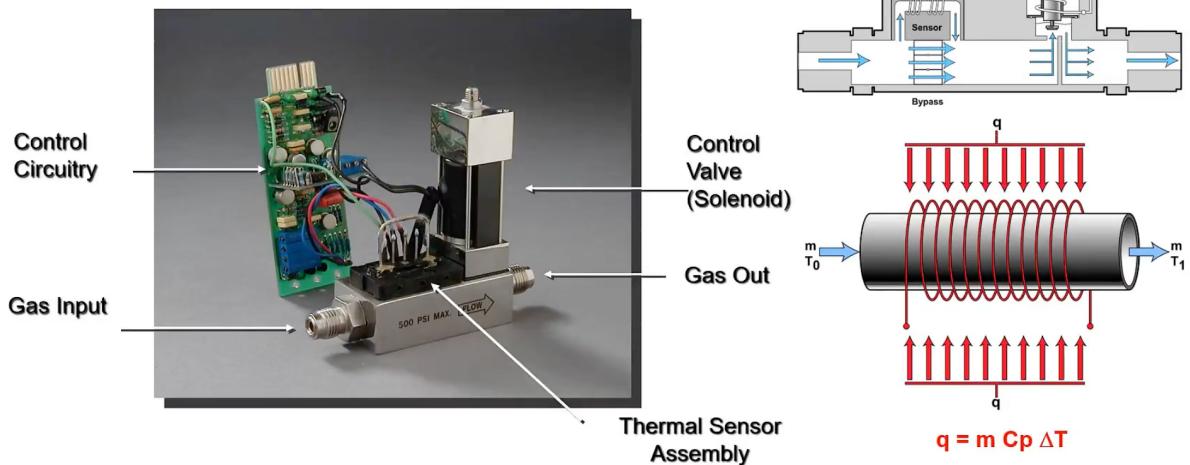
# 刻蚀设备



- 供气系统: MFC供气阀, 控制气体流量

o

## MFC



- EPD: 终点检测系统
- Chiller: 等离子体轰击过程中产生大量的热量, 需要对chamber壁、基座进行降温冷却
- 真空系统: APC阀、TMP、Dry Pump(真空泵)

o

## APC 阀

➤ APC: Adaptive Pressure Controller (适应性压力控制器)



- 射频系统

## 射频电源

-一般RF电源频率有两种, 分别为 **HP:13.56MHz** 和 **LP:3.2MHz**

-Source RF: 加快粒子碰撞频率、增加Plasma浓度;

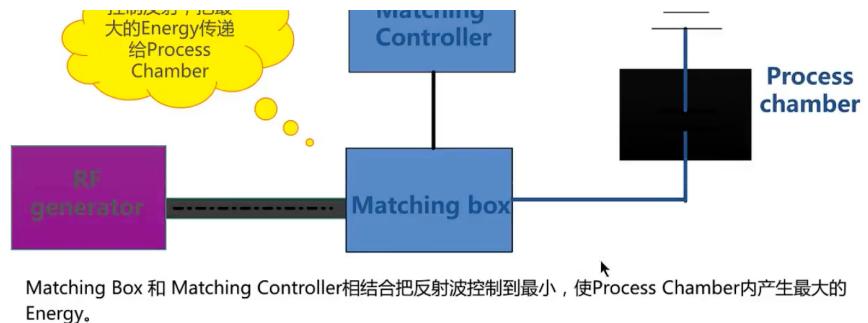
-Bias RF: RF周期较长, Ion可以获得更大的速度, 使Ion到达下部电极(基板)时的能量增大, 使Plasma到达稳定的时间缩短, 提高Plasma Uniformity。

控制反射 押晶

Matching

—

**RF (Radio Frequency):**  
提供激发电浆并维持蚀刻的能量来源



o